

§ 3 HlSchV Unterlagen

HlSchV - Halbleiterschutz-Verordnung

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

1. (1) Zur Identifizierung oder Veranschaulichung der Topographie sind folgende Unterlagen einzureichen:
 1. Zeichnungen oder Photographien von Layouts zur Herstellung des Halbleitererzeugnisses, oder
 2. Zeichnungen oder Photographien von Masken oder ihren Teilen zur Herstellung des Halbleitererzeugnisses, oder
 3. Zeichnungen oder Photographien von einzelnen Schichten des Halbleitererzeugnisses.
2. (2) Zusätzlich zu den in Abs. 1 genannten Unterlagen können Datenträger oder Ausdrücke davon oder das Halbleitererzeugnis selbst, für dessen Topographie Schutz beantragt wird, oder eine erläuternde Beschreibung eingereicht werden.

In Kraft seit 01.10.1988 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at